

技術詞彙

本技術詞彙載有於本文件中就本集團及本集團業務所使用若干詞彙的說明及定義。該等詞彙及彼等的涵義未必與他人使用該等詞彙的涵義或用途對應。

「元件結構」	指	排列均質或多層半導體材料的裝置或安排的結構，其加工方式為控制式執行預定電子性能
「晶粒」	指	自晶圓切割未經封裝的一塊獨立芯片
「固晶機」	指	自晶圓挑揀晶粒並貼裝至高密度導線架的機器
「固晶」	指	將外殼黏接晶粒(或芯片)黏著墊的工藝流程
「二極管」	指	雙極半導體元件，一般只允許電流單向流動
「離散元件」	指	封裝於外殼的單晶硅，執行單一功能
「EPI」	指	磊晶，用於晶圓加工流程的原材料
「ISO」	指	國際標準化組織，全球國家標準聯盟組織
「ISO 9001」	指	ISO出版以作設計、開發、生產、安裝及售後服務品質保證的質量管理體系模式
「激光」	指	由機器產生的幼束集中光束，例如在製程中用於切割或光刻半導體的激光打標機
「激光打標」	指	以機器在半導體表面刻蝕字型或標誌
「導線架」	指	用於半導體封裝組裝的主要材料之一，用作於覆晶前組裝晶粒及接合結構的載體
「LED」	指	發光二極管，一種雙極半導體光源

技術詞彙

「黏晶」	指	在半導體製程中加工元件的工序。晶圓在該流程黏裝至膠帶。晶圓黏裝的黏著膜確保於切割晶圓為晶粒的流程中維持個別晶粒位置固定
「MOSFET」	指	金氧半場效晶體管，一種用作放大或調制電子訊號的晶體管
「金氧半蕭基整流器」	指	建基於金屬氧化半導體(金氧半)技術的一種整流器
「光刻」	指	使用微加工以將薄膜的一部分或光刻膠在大範圍形成圖型的流程
「電鍍」	指	以電渡溶液在物體形成金屬塗層
「個人電腦」	指	個人電腦
「整流器」	指	一種半導體元件，其通過只允許電流單向流通而將交流電轉換為直流電
「蕭基整流器」	指	一種整流器
「半導體」	指	在室溫下在導體至絕緣體之間導電的一種固體材料
「錫鉛焊料」	指	在印刷電路板用作連接表面黏裝集成芯片封裝外殼的引腳與電路圖形中接著點(焊盤)的組件物質
「超接面」	指	一種應用電荷平衡理論的技術
「超接面 MOSFET」	指	建基於超接面技術的一種MOSFET
「浪湧」	指	一種瞬間高安普電流，一般由電壓失衡引致，可能在電網中傳播
「同步整流器MOSFET」	指	用於整流的一種MOSFET
「晶體管」	指	一種半導體元件，可用於放大及調制電子訊號及電力
「溝道式蕭基整流器」	指	建基於溝道式技術的一種整流器
「修邊機」	指	半導體製造時用作加工元件的機器，用於裁切覆晶

技術詞彙

「晶圓」	指	薄片狀半導體材料，例如硅晶，於製程中可加工為集成電路或離散元件列陣
「線焊機」	指	用作以金屬線黏接晶粒至導線架的機器
「線焊」	指	精密焊接晶片墊以及光刻膠墊的工藝流程